

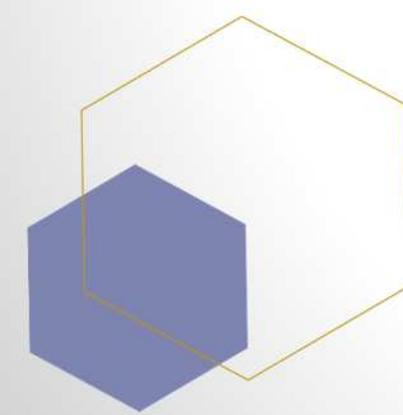
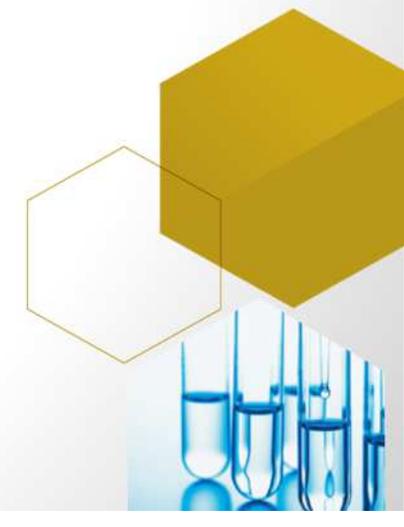
2024年3月期 第2四半期 決算説明資料

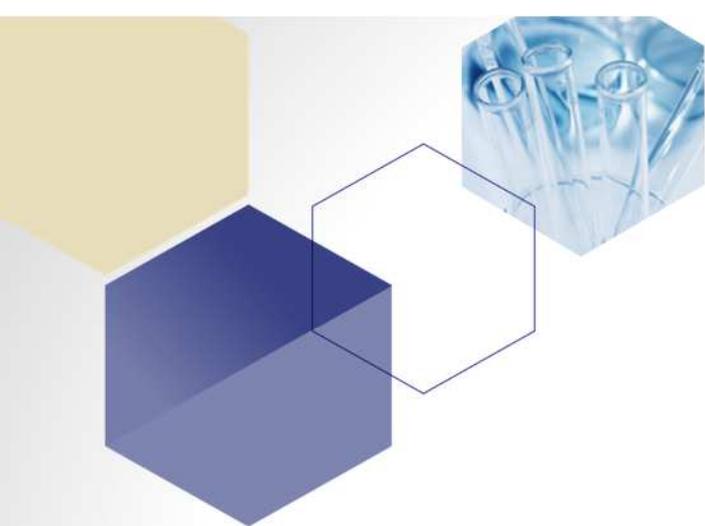


日本高純度化学株式会社

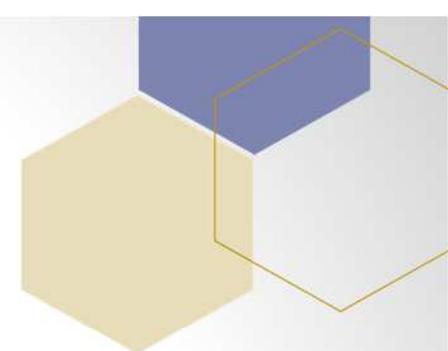
証券コード：4973

2023年10月24日

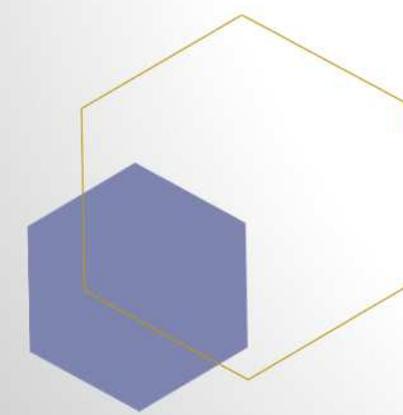
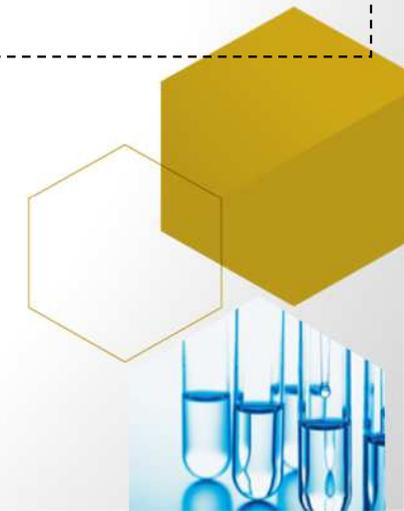




決算の概況



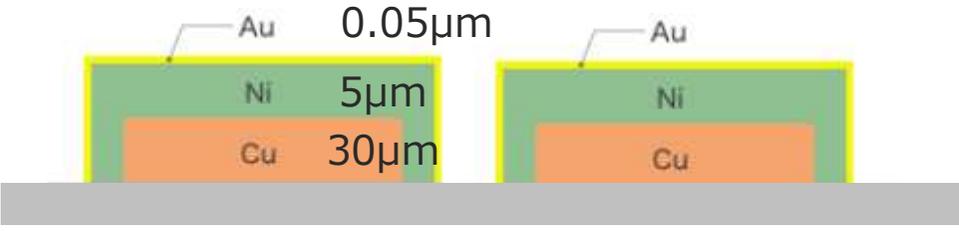
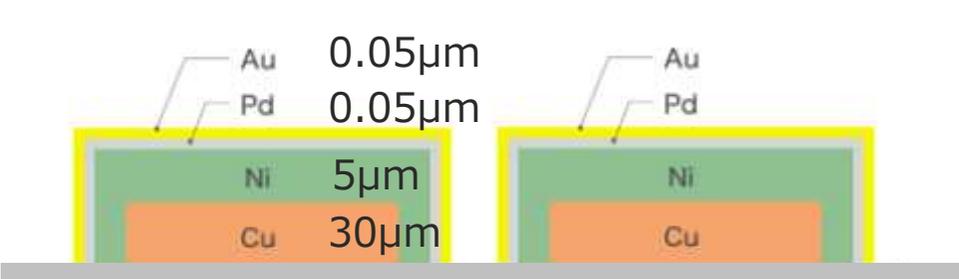
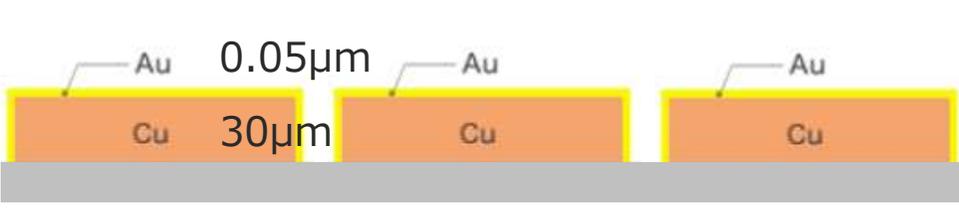
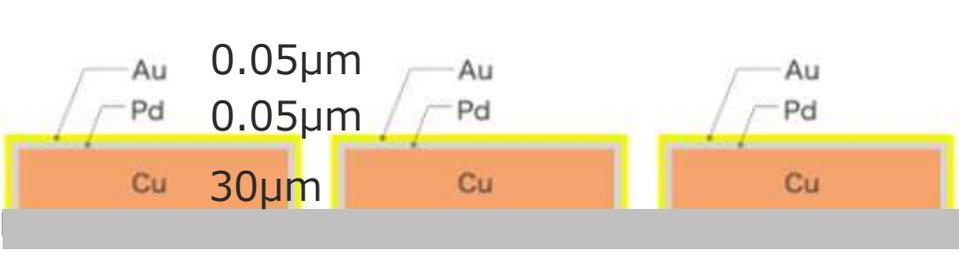
(注) 当社業績の見方のポイント

- ▶ 売上高は、薬品と一緒に貴金属を販売する場合と、薬品のみを販売する場合とで大きく変動します。
 - ▶ 貴金属は、価格変動があり、かつ高価なため、売上高に大きく影響します。
- 
- 

用語説明①（めっき方式）

| 用語 | 用途 | 説明 |
|-------------------|-------------------|---|
| 電解めっき (電気めっき) | — | 金属などの表面に電気を流してめっきする方法 |
| 純金めっき | プリント基板 半導体搭載基板 | 高純度な純金めっき |
| 硬質金めっき | コネクタ プリント基板 | 合金成分を入れて硬くした合金めっき |
| パラジウム (Pd) めっき | リードフレーム コネクタ | 金めっきの下地めっきとして使用される |
| 無電解めっき | — | 電気を流さず化学反応によりめっきする方法 |
| 置換めっき | プリント基板 | 金属ごとの溶けやすさ（イオン化傾向）を利用し、下地金属の表面を置き換えて形成するめっき方法 |
| 還元めっき | プリント基板 | 還元剤による化学反応を利用し、厚く形成できるめっき方法 |

用語説明②（めっきプロセス）

| 用語 | 説明 | めっき層構成 |
|--------|---|---|
| ENIG | 銅上に無電解ニッケルめっき及び置換金めっきをする方法。Electroless Nickel Immersion Goldの略 層構成はCu-Ni-Au |  <p>Two cross-sectional diagrams of ENIG plating. The left diagram shows a copper (Cu) base with a 30µm thick layer of nickel (Ni) and a 0.05µm thick layer of gold (Au) on top. The right diagram shows a similar structure with a 30µm Cu base, a 5µm Ni layer, and a 0.05µm Au layer.</p> |
| ENEPIG | 銅上に無電解ニッケルめっき、無電解パラジウムめっき及び置換金めっきをする方法。Electroless Nickel Electroless Palladium Immersion Goldの略 層構成はCu-Ni-Pd-Au |  <p>Two cross-sectional diagrams of ENEPIG plating. The left diagram shows a copper (Cu) base with a 30µm thick layer of nickel (Ni), a 0.05µm thick layer of palladium (Pd), and a 0.05µm thick layer of gold (Au) on top. The right diagram shows a similar structure with a 30µm Cu base, a 5µm Ni layer, a 0.05µm Pd layer, and a 0.05µm Au layer.</p> |
| DIG | 銅上に置換金めっきを直接する方法。Direct Immersion Goldの略 Niめっきを省いているためENIGに比べファインピッチ対応が可能。層構成はCu-Au |  <p>Three cross-sectional diagrams of DIG plating. Each diagram shows a copper (Cu) base with a 30µm thick layer of gold (Au) on top.</p> |
| EPIG | 銅上に無電解パラジウムめっき及び置換金めっきをする方法。Electroless Palladium Immersion Goldの略 層構成はCu-Pd-Au |  <p>Three cross-sectional diagrams of EPIG plating. Each diagram shows a copper (Cu) base with a 30µm thick layer of palladium (Pd) and a 0.05µm thick layer of gold (Au) on top.</p> |

製品ラインアップ ～ラインアップ拡充と新分野開拓～

| めっき方式 | | 用途 | 製品ラインアップ | |
|-------|-------------|---|---|--|
| 電解 | 純金 |  | ① 粗面上でも均一な膜厚が得られる純金めっき ② 硬度の高い純金めっき | |
| | 硬質金 (合金) |  | マイクロコネクタ用省金硬質金めっき | オーロブライト BAR7 |
| | パラジウム(Pd) |  | PPF用薄膜パラジウムめっき (PPF: Pre Plated Lead frame) | パラブライト NANO2 |
| 無電解 | 置換金 |  | 中～高リンニッケルで使える置換金めっき 下地ニッケルの腐食が少ない置換金めっき ニッケル不使用置換金めっき | IM-GOLD IB2X IM-GOLD CN IM-GOLD PC |
| | 還元金 |  | 亜硫酸金を使った薄膜還元金めっき シアン化金を使った薄膜還元金めっき | HY-GOLD HY-GOLD CN |
| | 還元Pd |  | ENEPIG用還元パラジウムめっき ニッケル不使用還元パラジウムめっき | ネオパラブライト 2 ネオパラブライト DP |

周辺分野

卑金属（銅、スズ、ニッケル）
合金めっき 後処理剤など

2024年3月期 第2四半期決算概況

電子部品業界の状況

- 世界的な金利高止まりや中国経済の景気回復減速の影響から、スマートフォンやパソコンなど民生向けにおいては需要回復基調にあるものの、期初見込みほどの需要増は見られず
- クラウド/データセンター向けや半導体装置/FA機器などの産業機器向けにおいては、生成AI向けなどで需要の伸びがみられたが、総じて投資の調整局面にあり、需要回復には至らず
- 車載用電子部品については、半導体不足の緩和とEV1台あたりの搭載数増加による継続的な需要増はあるものの、回復は緩やか

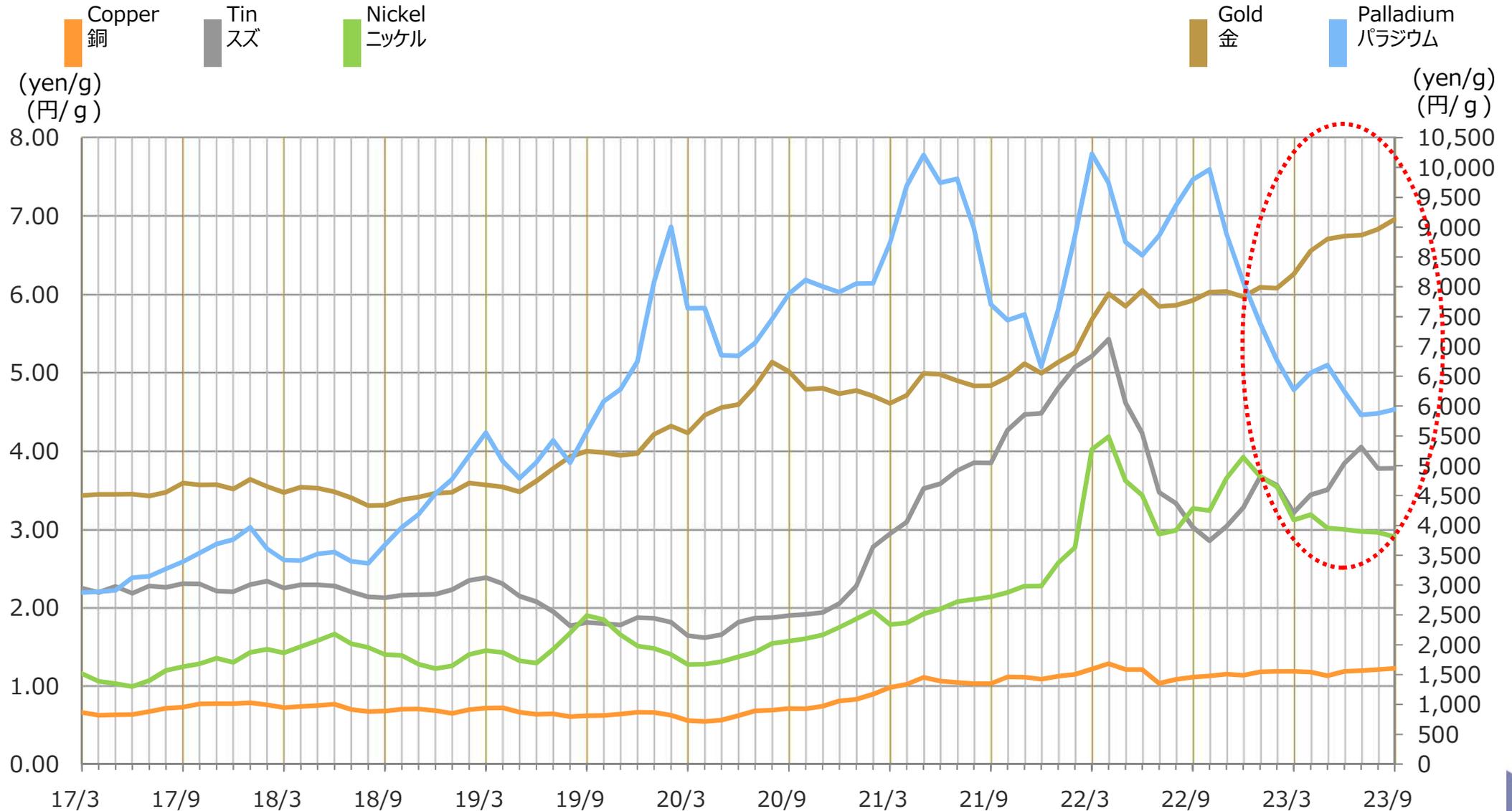
当社決算の概況

- プリント基板・半導体搭載基板用めっき薬品
生成AI向けなど一部の最先端半導体パッケージ向けなどで需要増が見られたが、スマートフォンやパソコン向け、およびこれらのメモリ向けで低調に推移し、当初期待したほどの受注回復には至らず
- コネクタ用めっき薬品
製品の技術優位性から産業機器向けで需要増が見られたものの、スマートフォン向けの低迷を補えず
- リードフレーム用めっき薬品
スマートフォンやパソコン向けの需要低迷の影響を受け販売が低調に推移し、さらにパラジウム価格下落の影響により減収

メタル相場推移

Prices of copper, tin and nickel
銅、スズ、ニッケル価格

Prices of gold and palladium
金、パラジウム価格



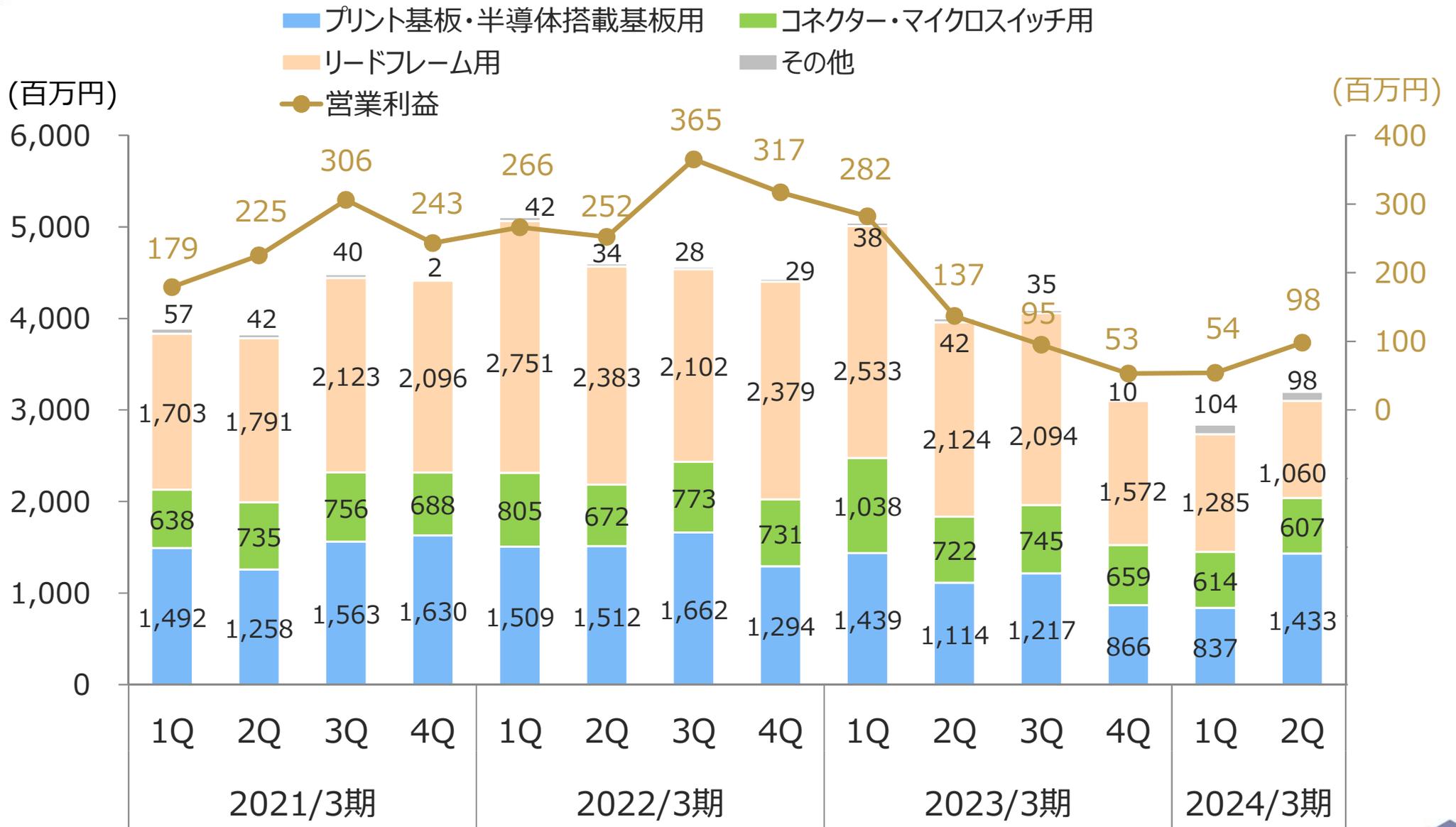
2024年3月期 第2四半期決算概況

(単位：百万円、%)

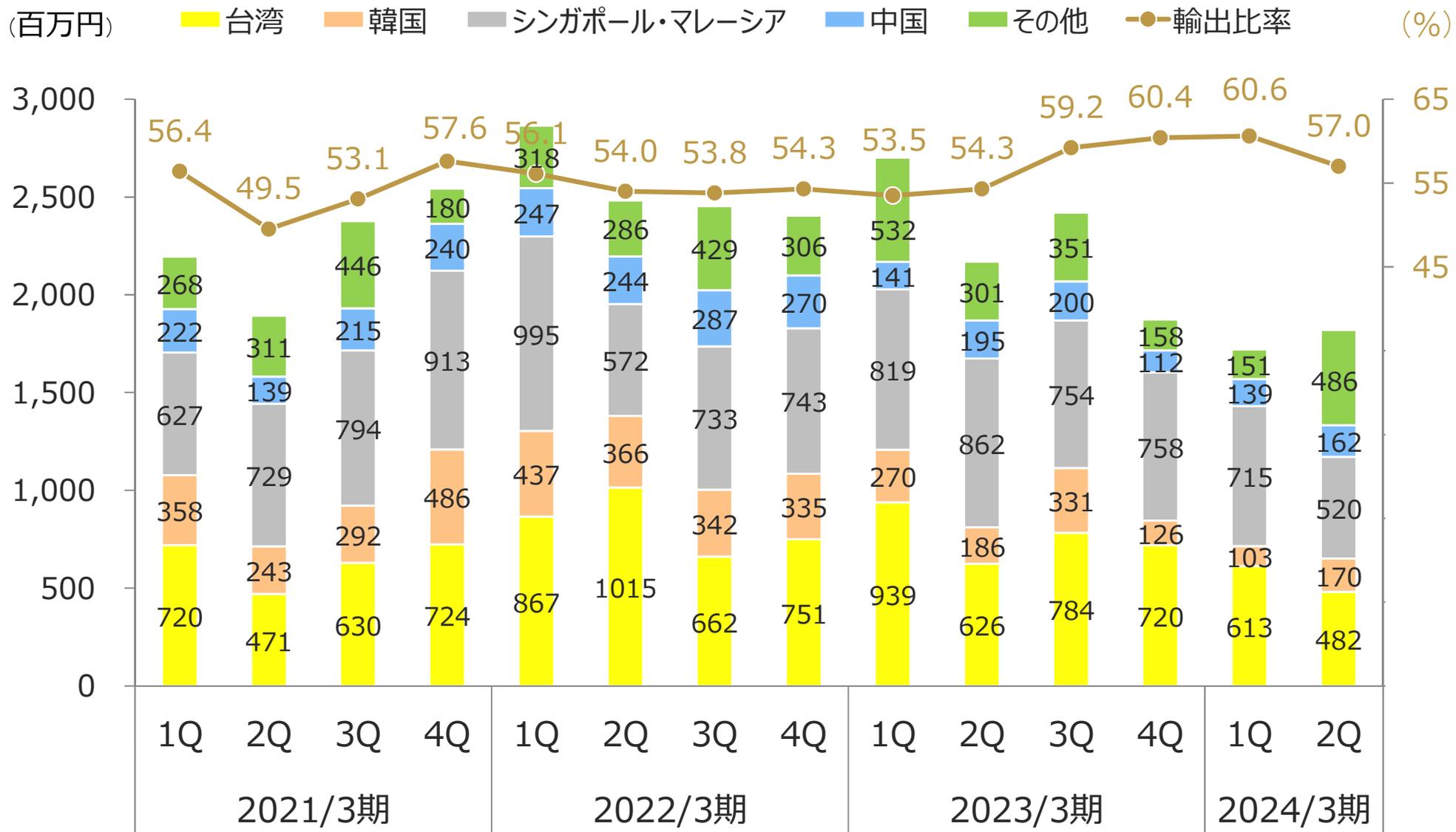
| | 2023/3期 1Q~2Q | 2024/3期 | | | |
|-----------------|------------------|---------|--------|--------|--------|
| | | 1Q | 2Q | 1Q~2Q | 増減率 |
| 売上高 | 9,054 | 2,843 | 3,199 | 6,042 | △33.3% |
| 営業利益 | 419 | 54 | 98 | 153 | △63.5% |
| 経常利益 | 518 | 154 | 108 | 262 | △49.4% |
| 四半期純利益 | 380 | 119 | 83 | 202 | △46.9% |
| 1株当たり 四半期純利益 | 64.93円 | 20.74円 | 14.42円 | 35.16円 | — |

- スマートフォンやPCなどの民生品、およびサーバ/データセンター向けのめっき薬品について、期初に想定したほどの需要回復に至らず、前年同期比で減収減益となりました

売上高・営業利益の推移（四半期ベース）



輸出地域別売上高の推移（四半期ベース）



2024年3月期 通期見通し

(単位：百万円、%)

| | 2023/3期 | 2024/3期 | | | |
|-------|---------|--------------------|---------------------|--------|--------|
| | | 期初公表値 (2023年4月) | 今回見込み (2023年10月) | 増減 | |
| | | | | 前期比 | 4月比 |
| 売上高 | 16,254 | 16,500 | 13,500 | △16.9% | △18.2% |
| 営業利益 | 567 | 700 | 510 | △10.2% | △27.1% |
| 経常利益 | 753 | 850 | 710 | △5.8% | △16.5% |
| 当期純利益 | 569 | 600 | 520 | △8.8% | △13.3% |
| 配当 | 80円 | 80円 | 100円 | +20円 | +20円 |
| ROE | 4.1% | 4.5% | 3.9% | — | — |

- スマートフォンやP Cなどの民生品の需要は回復傾向であり、車載向けは年間を通して堅調
- 民生品およびサーバー/データセンター向けの需要回復が期初の想定よりも緩やかで、また産機向けは中国経済の回復遅れなどにより低調な推移を予想する
- 配当方針にDOEを採用することに伴い、年間100円（うち中間40円）とする

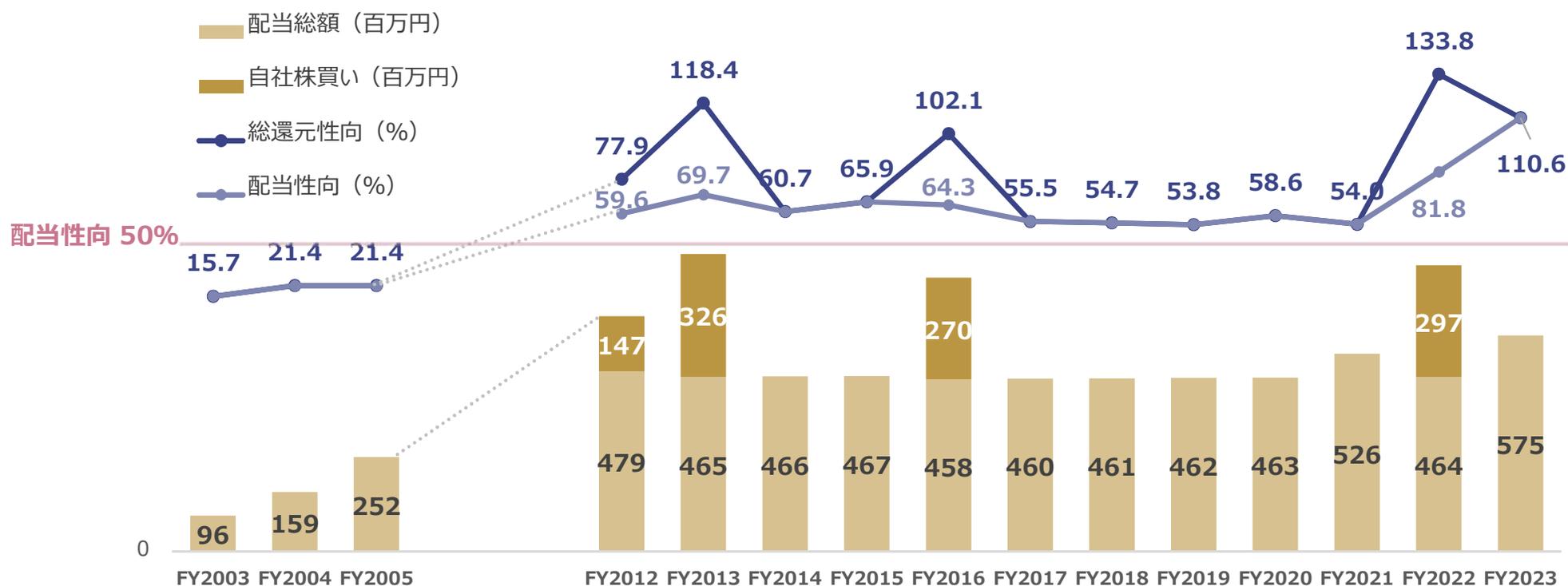
株主還元

基本方針（FY2022-2024）

- 長期的な成長を目指して、資本効率と財務健全性のバランスを取る
- プライム市場上場会社として、当面の業績に大きく左右されない一定レベルの株主還元積極的に取り組む
- 配当性向に加え DOE（自己資本配当率）5%を下限とした配当方針を採用する(2024年3月期期末配当から適用)
- 自己資本水準の最適化を図る中で、資本に関連する指標（ROE、DOE）の算出方法を従来の株主資本ベースから自己資本ベースに見直す
- 自己株式の取得についても状況に応じて、機動的に実施を検討する

配当性向・自社株買い・総還元性向の推移

※百万円以下切り



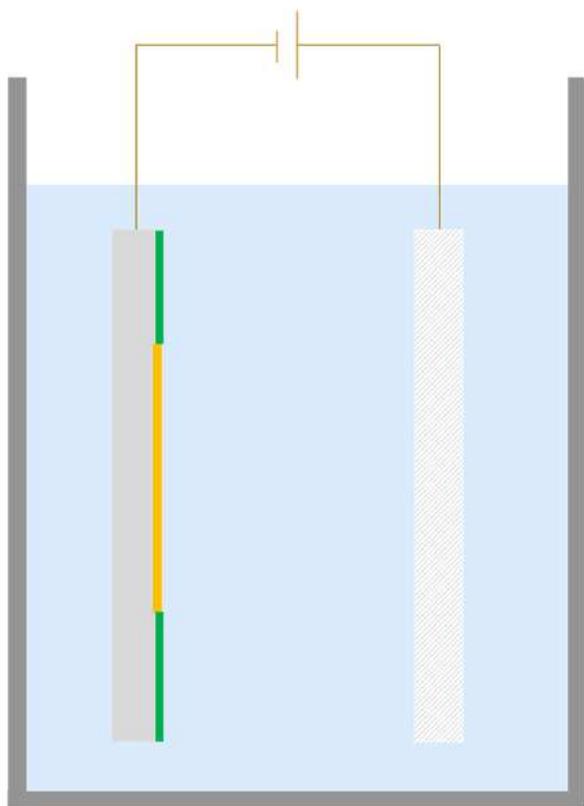
環境負荷を大幅に低減する「スタンプ式めっき処理」



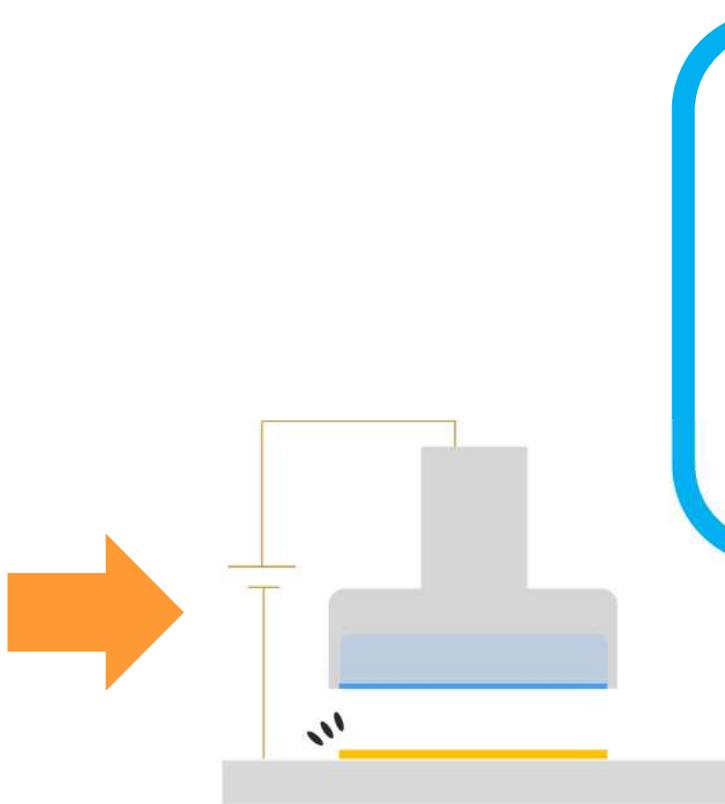
■スタンプ式めっきとは

- トヨタ自動車が開発したスタンプを押すようにめっき処理する技術
- 必要な部位にだけ膜を押し当てながら電解めっきする
- 少量のめっき液で処理できるため、従来めっきに比べ廃液及び消費電力の削減が可能

■従来めっき



■スタンプ式めっき



廃液量 \doteq $\frac{1}{30}$

CO₂量 \doteq $\frac{1}{3}$

世界初 スタンプ式めっき用 金薬品の開発に成功



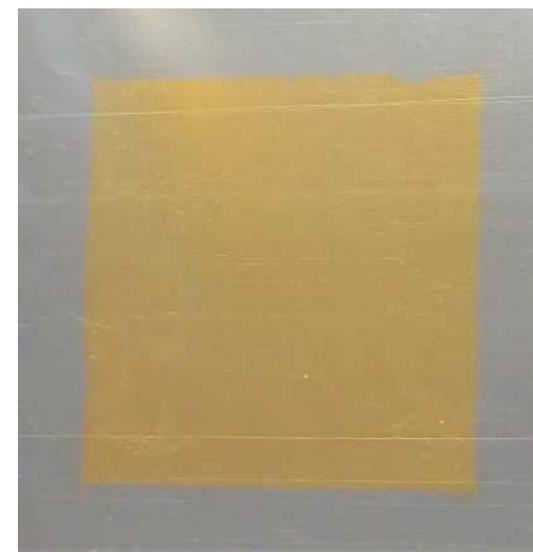
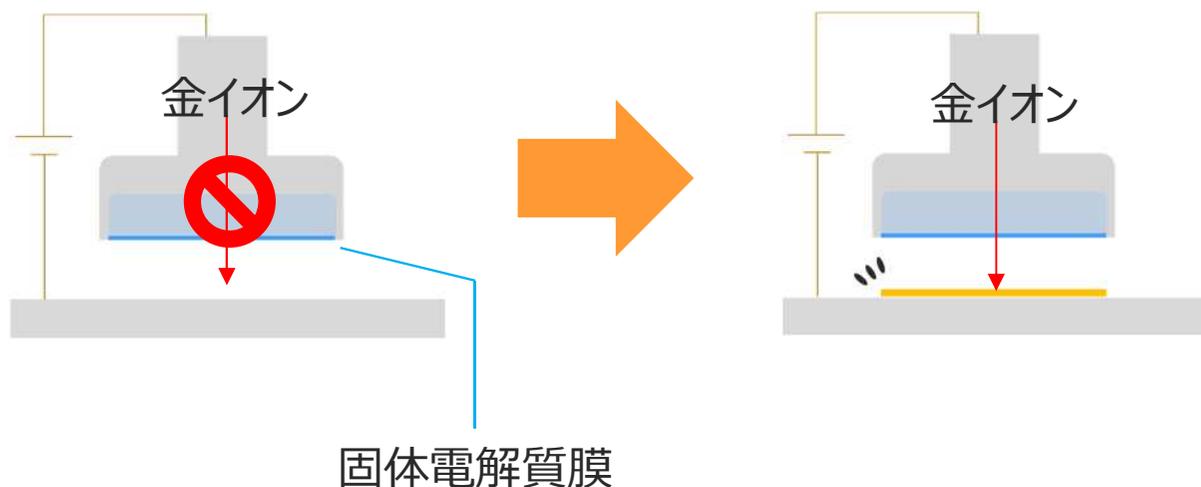
■ スタンプ式金めっき実現の課題

従来の金めっき薬品では
膜を安定に通過できなかった...

■ 当社スタンプ式めっき用金めっき薬品の特徴

- シアンフリーの環境配慮型
- レモンイエロー金めっき皮膜
- ワイヤーボンディング性良好

膜通過性を付与する技術を開発



■ 今後の展開

スタンプ式めっき処理装置との最適化を行い、サンプル評価に向けた準備を進める

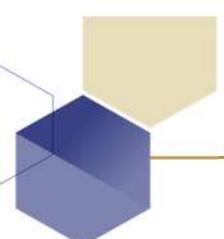
補足資料：会社紹介

沿革

- 1971年 7月 会社設立
- 1999年 11月 MBOを実施
- 2002年 12月 JASDAQ市場に上場
- 2004年 3月 東京証券取引所市場第二部に上場
- 2005年 3月 東京証券取引所市場第一部に上場
- 2019年 2月 一般財団法人JPC奨学財団設立
- 2020年 4月 公益財団法人JPC奨学財団に認定
- 2022年 4月 東京証券取引所プライム市場に移行

事業概要

- 電子部品業界の発展を支える電子材料を供給するファインケミカル企業
- 事業のターゲットを貴金属めっき薬品に絞り世界シェアトップクラス
- 変化の激しい業界にスピーディーに対応できる販売体制と技術サポート体制を構築
- 大規模な製造プラントを必要としないファブレス企業
- 電子部品の接続に用いる貴金属の使用量を最小限に抑える技術を提供し、資源の有効利用に貢献



注意事項・免責事項

当該資料で用いられている業績予想ならびに将来予測は、いずれも当社の事業に関連する業界の動向についての見通し、国内および諸外国の経済状況、ならびに為替レートの変動、その他の業績へ影響を与える要因について、2023年9月時点で入手可能な情報をもとにした予想を前提としています。

これらは、市況、競争状況、新製品およびサービスの導入およびその成否、ならびに情報通信関連産業の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。よって、実際の業績は配布資料および決算説明で用いる予想数値とは、大きく異なる場合があることをご了解いただきますようお願い致します。

この資料の著作権は日本高純度化学株式会社に帰属します。いかなる理由によっても、当社に許可なく資料を複製・配布することを禁じます。

お問い合わせ先

TEL. 03-3550-1048 FAX. 03-3550-1006

経営企画部

<https://www.netjpc.com>